

LINTEC

WAVE

株主通信誌

JUNE 2026

99

【特集】

半導体関連事業の革新

第132期

(2026年3月期)

決算情報

証券コード：7966

LINTEC WAVE 99

JUNE 2026



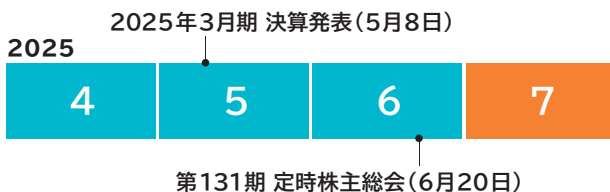
ひるぜん
蒜山高原(岡山県)
大山の裾野に広がり、雄大な自然と多くの観光スポットが集まる。「ひるぜんジャージーランド」の広大な敷地に咲き誇るひまわりは、蒜山の夏の風物詩となっている。

目次

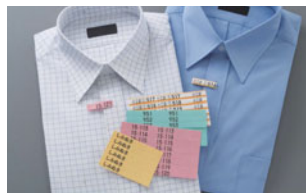
- 2 1年間の主な動き
- 4 株主・投資家の皆様へ
代表取締役社長
社長執行役員 服部 真
- 6 特集
半導体関連事業の革新
- 8 トピックス
- 9 会社概要／役員一覧
- 10 決算情報
- 12 セグメント情報
- 15 株式情報

(免責事項)
業績予想などの将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績などはさまざまな要因により大きく異なる可能性があります。

1年間の主な動き



- 5月13日
- TBSのトーク番組「マツコの知らない世界」で、クリーニングタグとして使用される当社の耐洗紙が紹介



耐洗紙の使用例

- 6月20日
- 300万株、83億円の自己株式の取得が完了

- 7月11日
- 「SOMPOサステナビリティ・インデックス」構成銘柄に選定



- 7月14日
- PETボトルなどからリサイクルしたPET樹脂を100%使用した建物用ウインドーフィルムの日射調整タイプを発売



ウインドーフィルムの施工イメージ

2026年3月期 第1四半期 決算発表(8月7日)



2026年3月期 第2四半期 決算発表(11月7日)

2026年3月期 第3四半期 決算発表(2月9日)

7月29日

- ログミー Finance主催のオンラインでの個人投資家向け会社説明会に参加

8月28日

- 靴や自動車の内装などに幅広く使われる合成皮革の製造工程で使用される工程紙の主力生産拠点に新規塗工設備を導入



小松島工場(徳島県)の新設備

9月3日

- 次世代半導体パッケージのコンソーシアム「JOINT3」への参画を発表



9月8日

- YouTubeの新チャンネル「リンテック科学TVプラス」を開設

11月10日

- 粘着シートやコートフィルムに関わる特許3件が「令和7年度 関東地方発明表彰」の「発明奨励賞」を受賞

12月19～21日

- 「第94回 全日本フィギュアスケート選手権大会」に協賛

1月14日

- 経済産業省が定めたDX経営に求められる指針に対応する企業として認定を取得



2月13日

- 山梨県韮崎市の鳳凰山域における生物多様性の保全および増進に関する協働協定を締結

2月18日

- 半導体チップの歩留まり向上に貢献する樹脂塗布プロセスの開発を発表 ※P.7参照

3月8日

- 大和インベスター・リレーションズ(株)主催の個人投資家向け会社説明会に参加 ※P.8参照



代表取締役社長
社長執行役員
はっとり まこと
服部 真

▶ 2026年3月期連結業績(前期比)

売上高

319,385百万円 (1.1%増)

営業利益

25,156百万円 (2.4%増)

経常利益

25,666百万円 (1.6%減)

親会社株主に帰属する当期純利益

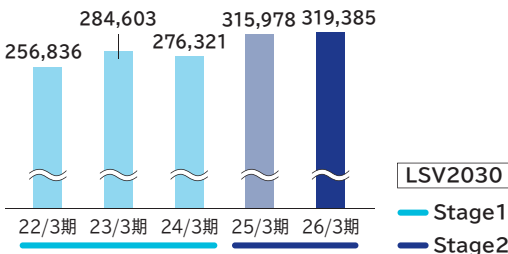
17,374百万円 (20.0%増)

🟡 2026年3月期連結業績の振り返り

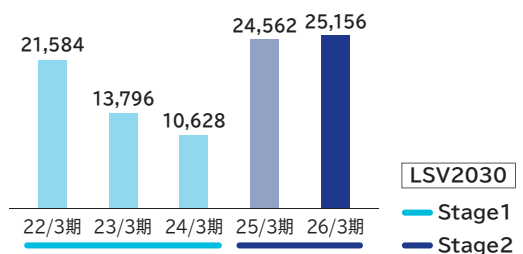
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。2026年3月期の世界経済は、米国による関税政策が各国の経済に大きな混乱を来したものの、各国の景気刺激策などによって個人消費や設備投資が底堅く推移し、緩やかな回復軌道をとりました。我が国においては食料品を中心に物価上昇が続いているものの、雇用や所得環境の改善を背景に個人消費が持ち直すなど景気は緩やかに回復しま

した。当社グループの2026年3月期連結業績につきましては、売上高はAI関連の需要増加により半導体・電子部品関連製品が引き続き堅調に推移し、利益面では原燃料価格の上昇や人件費を含む固定費の増加があったものの、販売数量の増加などで増益効果がありました。この結果、売上高と営業利益ともに2期連続で過去最高を更新することができました。

売上高 (百万円)



営業利益 (百万円)



2027年3月期の見通し

2027年3月期につきましては、世界経済は活発なAI関連投資や各国の積極的な財政政策に支えられて引き続き成長が期待されるものの、米国の高関税政策や中東情勢の緊迫化により景気減速懸念も増しており、予断を許さない状況が継続すると予想しています。中東情勢起因の原燃料価格や物流コストの上昇が当社グループの経営環境に極めて大きな影響を及ぼし、サプライチェーンにおいて調達に支障を来す可能性も払拭できませんが、お客様への製品供給に最大限努めていきます。こうした世界情勢に加えて、賃上げによる人件費や新規生産設備導入による減価償却費などの固定費増加が利益を押し下げる要因となりますが、前期に引き続き半導体・電子部品関連製品の売り上

げが伸長すると見込んでおり、業績予想は増収増益としています。また、今期の年間配当金は通期連結業績予想を踏まえ、前期から10円増額の120円を予定し、3期連続の増配を見込んでいます。なお、配当性向は40.3%となる見込みです。当社は株主の皆様への利益還元の充実を経営上の最重要課題の一つと位置づけており、今後も充実を図ってまいります。

2027年3月期連結業績予想(前期比)

売 上 高	3,420億円 (7.1%増)
営 業 利 益	275億円 (9.3%増)
経 常 利 益	275億円 (7.1%増)
親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益	195億円(12.2%増)

長期ビジョンの実現に向けて

当社グループでは2030年のあるべき姿を見据えた長期ビジョン「LINTEC SUSTAINABILITY VISION 2030 (LSV 2030)」を2021年に掲げ、その実現に向けたマイルストーンとして3か年ごとの中期経営計画を策定・推進しています。中期経営計画「LSV 2030 - Stage 2」の最終年度となる今期はこれまで取り組んできた重要施策の成果を確実に出し、「Stage 3」への弾みをつけることで長期ビジョン実現への確度を高め

ていきます。「Stage 2」の最終年度で掲げた売上高営業利益率8%以上やROE(自己資本当期純利益率)8%以上などの各種経営目標を達成すべく、成長事業に対する積極的な投資や資産・資本効率の改善、事業ポートフォリオの最適化などに積極的に取り組み、さらなる企業価値向上に努めていきます。株主・投資家の皆様には引き続きご支援のほど、よろしくお願い申し上げます。

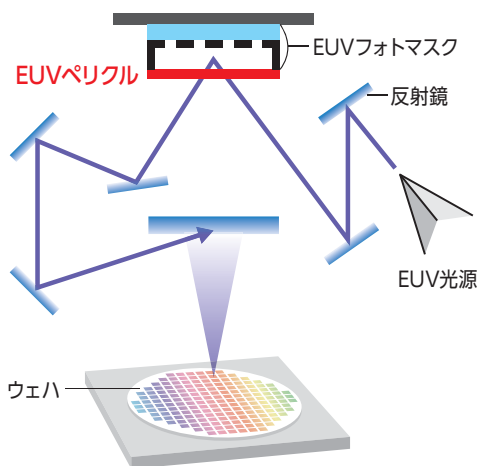
当社は成長分野に位置づける半導体関連事業に研究開発費などを積極的に投じ、将来にわたる競争力を磨き続けています。今号では、研究開発や本格生産に向けた取り組みを推進しているEUV露光機用CNT(カーボンナノチューブ)ペリクルの最新情報のほか、4月に本格受注を始めた半導体関連の新装置をご紹介します。

CNT製ペリクルの開発と本格生産に向けた取り組みを加速

ペリクルとは、半導体製造工程においてフォトマスク(回路パターン原版)への異物の付着を防ぐ防塵膜の役割を果たす部材です。従来はポリシリコンなどをベースとする素材が使われてきましたが、近年は先端半導体の微細回路形成に不可欠なEUV露光機の性能向上に伴い、より高耐久で信頼性の高いCNT製ペリ

クルが求められています。当社グループでは、CNTシートの開発を手がける米国・テキサス州の研究開発拠点においてペリクルの開発に着手し、2023年に要素技術を確認した後、国立研究開発法人産業技術総合研究所(産総研)先端半導体研究センターとの共同研究に着手するなど、社会実装へ取り組んできました。

そしてこのたび、茨城県の産総研つくばセンター中央事業所内に、当社の新たな研究開発・生産拠点として「つくばイノベーションクリエーションセンター」を開設。同拠点には、先端半導体の微細回路形成に欠かせないCNT製ペリクル膜の生産設備および関連設備も導入しました。まずはフルサイズのペリクルサンプルの供給に着手するとともに、検査装置や製品供給に必要な付帯設備なども段階的に導入する計画です。お客様によるサンプル評価を基に、さらなる製品開発と本格生産に向けた取り組みを加速していきます。



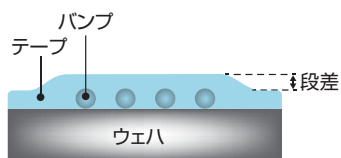
EUV露光機内のイメージ

半導体チップの歩留まり向上に貢献する 樹脂塗布プロセスを開発

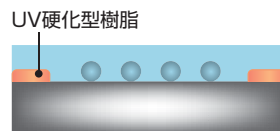
半導体チップの微細化が進むにつれ、製造工程ではウェハの裏面を平坦に研削するバックグラインド工程の重要性が高まっています。特にウェハ全体の厚みのばらつきを抑え、高い平坦性を確保することが半導体チップの品質向上に欠かせません。ただ、回路面にバンプと呼ばれる突起電極が形成されたウェハのように中央と外周部で高低差がある場合、ウェハ研削に当たり表面を保護する「バックグラインドテープ」を貼付した際、外周部に段差が生じ、これが研削時にクラック（欠けやひび割れ）が生じる原因にもなります。

そこで当社では、バンプのない外周部にUV硬化型の樹脂を塗布することでこの段差を解消し、ウェハ研削後の厚みのばらつきやクラックの発生を低減する「PCBL(Pattern Coating Before Lamination)プロセス」を開発。段差を解消するために樹脂を塗布する新装置「RAD-3400F/12」も開発し、この4月から本格受注を開始しました。同装置は塗布する樹脂のパターンや塗布量、幅や高さを調整することで、バンプの高さなどウェハの仕様に合わせたカスタマイズが可能です。当社は同装置やPCBLプロセスの提案を強化することで、半導体チップ製造における歩留まり向上へのさらなる貢献を目指していきます。

UV硬化型樹脂塗布なし



UV硬化型樹脂塗布あり



ウェハの仕様に合わせて
カスタマイズできる新装置

個人投資家向け会社説明会に参加

3月8日に大和インベスター・リレーションズ(株)主催の個人投資家向け会社説明会に参加しました。社長の服部真が登壇し、説明会参加者約250人に向けて、会社概要や製品・技術の特徴、長期ビジョン・中期経営計画などを説明しました。当日の質疑応答パートでは個人投資家の方から半導体関連事業を中心に多くの質問を頂戴したほか、会場横に設けた当社製品の展示ブースにも足をお運びいただくなど、盛況のうちに終了いたしました。今回のような会社説明会への継続的な参加を通じて、当社の知名度向上や新規個人株主の獲得などにつなげていきます。



プレゼンテーションの様子



にぎわった当社展示ブース

会社説明会の動画はこちら ▶



複数の主要IR評価機関から高評価を獲得

当社のIRサイトが、主要IRサイト評価機関である大和インベスター・リレーションズ(株)から優秀賞(上場企業4,122社の上位27社以内)に選ばれました。また、(株)ブロードバンドセキュリティ、日興アイ・アール(株)からも同様に高評価を獲得しました。当社は投資判断に必要な情報を投資家の皆様を提供する窓口としてIRサイトを重視しています。引き続きIRサイトの改善・充実を図ることで、投資家の皆様への適時適切な情報開示を強化して対話機会の拡大に努めるとともに、積極的な情報開示によって当社への理解促進に取り組みます。



大和インベスター・リレーションズ
「大和インターネットIR表彰2025」



ブロードバンドセキュリティ
「Gomez IRサイトランキング2025」

当社IRサイト(株主・投資家情報)を御覧いただけます。▶



会社概要 (2026年3月31日現在)

社名	リンテック株式会社 (英文：LINTEC Corporation)
本社	東京都板橋区本町23-23
設立	1934年10月15日
資本金	233億5,598万1,761円
上場	東京証券取引所プライム市場
事業年度	毎年4月1日から翌年3月31日まで
従業員数	連結：5,237人 単体：2,673人
事業所	営業拠点：東京、札幌、名古屋、大阪、福岡など全国11か所 生産拠点：吾妻(群馬県)、熊谷・伊奈(埼玉県)、千葉(千葉県)、 龍野(兵庫県)、小松島(徳島県)、三島・土居(愛媛県) 研究拠点：蕨・さいたま(埼玉県)
連結子会社	国内：3社 海外：37社

役員一覧 (2026年6月22日現在)

取締役		執行役員	
代表取締役会長	大内 昭彦	専務執行役員	持田 欣也
代表取締役社長 社長執行役員	服部 真	専務執行役員	峯浦 芳久
取締役 専務執行役員	海谷 健司	常務執行役員	所司 悟
取締役 専務執行役員	松尾 博之	常務執行役員	妹尾 秀男
取締役 専務執行役員	吉武 正昭	常務執行役員	三宅 英樹
取締役 常務執行役員	柴野 洋一	執行役員	西角 尚志
取締役(社外)	佐野 孝典	執行役員	山本 直樹
取締役(社外)	独立 奥島 晶子	執行役員	青木 智
取締役(社外)	独立 白幡 清一郎	執行役員	沼澤 英樹
		執行役員	川上 豪毅
		執行役員	喜井 大介
		執行役員	木村 慶太
		執行役員	清水 充
		執行役員	京極 昌一
		執行役員	星 優
		執行役員	瀬川 丈士
		執行役員	竹内 栄一郎
		執行役員	山下 淳史
		執行役員	秋和 淳
		執行役員	大森 正義
監査等委員である取締役			
取締役/監査等委員	木村 雅昭		
取締役(社外)/監査等委員	独立 大澤 加奈子		
取締役(社外)/監査等委員	独立 杉本 茂		

連結財務諸表

連結貸借対照表(要約)

(単位:百万円)	当連結 会計年度	前連結 会計年度
流動資産	196,082	192,767
固定資産	146,643	147,703
① 資産合計	342,725	340,471
流動負債	65,968	69,989
固定負債	18,516	24,355
② 負債合計	84,485	94,345
③ 純資産合計	258,240	246,126
負債純資産合計	342,725	340,471

連結損益計算書及び連結包括利益計算書(要約)

(単位:百万円)	当連結 会計年度	前連結 会計年度
④ 売上高	319,385	315,978
売上総利益	81,463	79,844
販売費及び 一般管理費	56,306	55,282
⑤ 営業利益	25,156	24,562
経常利益	25,666	26,090
税金等調整前 当期純利益	24,472	18,753
⑥ 親会社株主に帰属する 当期純利益	17,374	14,476
包括利益	24,191	22,653

連結キャッシュ・フロー計算書(要約)

(単位:百万円)	当連結 会計年度	前連結 会計年度
営業活動による キャッシュ・フロー	33,450	33,715
投資活動による キャッシュ・フロー	△14,589	△24,666
財務活動による キャッシュ・フロー	△15,595	△12,332
現金及び現金同等物に 係る換算差額	1,283	1,591
現金及び現金同等物の 期末残高	55,252	50,703

① 「棚卸資産」の減少などがありましたが、「売掛金」や「退職給付に係る資産」の増加などにより、総資産は22億54百万円増加しました。

② 「支払手形及び買掛金」や「退職給付に係る負債」の減少などにより、負債は98億59百万円減少しました。

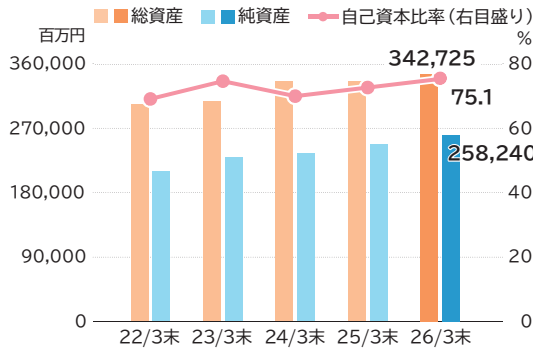
③ 「自己株式」の減少がありましたが、「利益剰余金」や「退職給付に係る調整累計額」の増加などにより、純資産は121億13百万円増加しました。

④ AI関連の需要増加により半導体・電子部品関連製品が堅調に推移したことにより、売上高は34億6百万円増加しました。

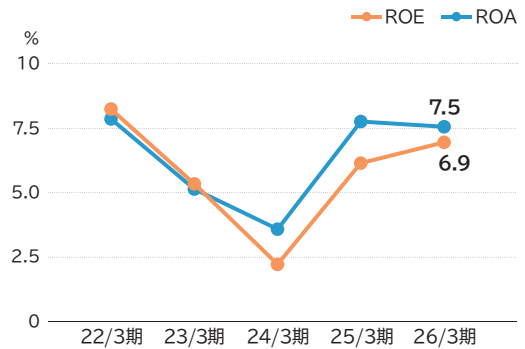
⑤ 原燃料価格の上昇や人件費を含む固定費の増加があったものの、販売数量の増加などにより、営業利益は5億94百万円増加しました。

⑥ 営業利益が増加したことや特別損失が減少したことなどにより、親会社株主に帰属する当期純利益は28億97百万円増加しました。

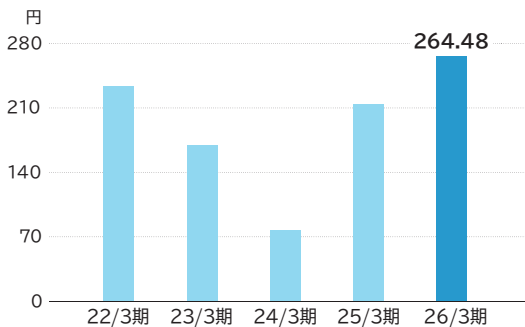
総資産・純資産・自己資本比率



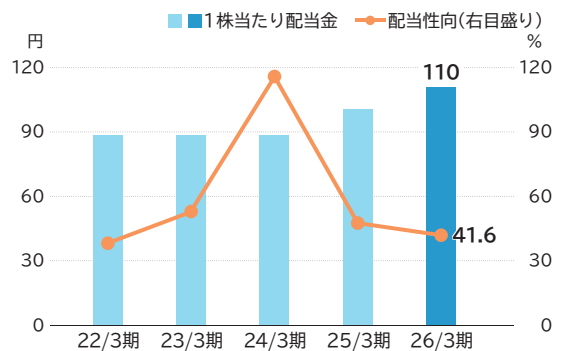
ROE (自己資本当期純利益率)・ROA (総資産経常利益率)



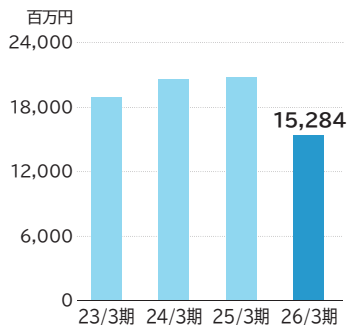
1株当たり当期純利益



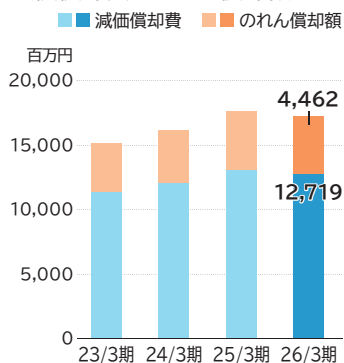
1株当たり配当金・配当性向



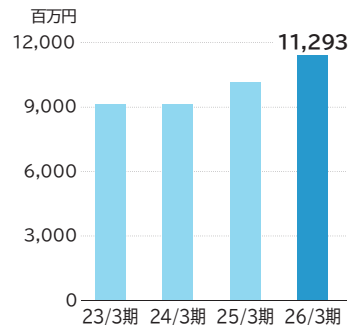
設備投資額



減価償却費・のれん償却額



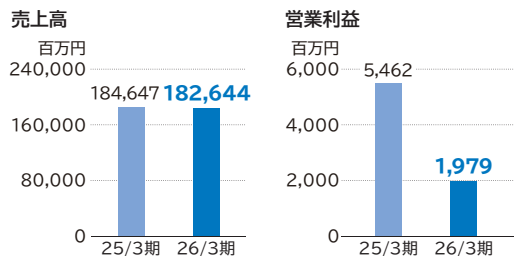
研究開発費



印刷材・産業工材関連 (前期比)

売上高 **1,826億44**百万円 (1.1%減)

営業利益 **19億79**百万円 (63.8%減)



印刷情報材事業部門 (前期比)

売上高 **1,455億17**百万円 (0.8%減)

主要製品

- シール・ラベル用粘着紙・粘着フィルム
- バーコードラベル用粘着紙・粘着フィルム



産業工材事業部門 (前期比)

売上高 **371億26**百万円 (2.3%減)

主要製品

- 自動車用粘着製品
- 工業用粘着テープ
- ラベリングマシン
- ウィンドーフィルム
- 屋外看板・広告用フィルム
- 内装用化粧フィルム



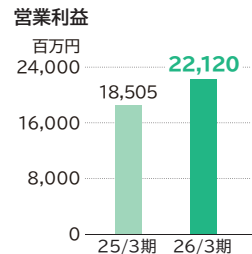
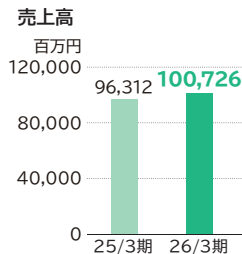
事業部門別の売上高とセグメント営業利益の概況

- 印刷情報材事業部門はシール・ラベル用粘着製品が、国内では食品関連や飲料キャンペーン用などは低調だったものの、医薬および物流用は堅調に推移し、アイキャッチ用の需要は回復しました。海外では米国で販売数量は増加したものの、売上構成や為替などの影響により減少したほか、アセアン地域においても低調に推移しました。
- 産業工材事業部門は国内では建物用ウィンドーフィルムが低調だったものの、自動車用ウィンドーフィルムや自動車用粘着製品は堅調に推移しました。海外では米国で防犯用ウィンドーフィルムの需要が低迷したほか、アセアン地域で自動車用粘着製品が減少しました。
- セグメント営業利益は国内で原燃料価格や物流コストの上昇、固定費増加の影響があったほか、米国で固定費の増加や工程歩留まりの悪化の影響を受け、前期に比べ減少しました。

電子・光学関連 (前期比)

売上高 **1,007億26**百万円 (4.6%増)

営業利益 **221億20**百万円 (19.5%増)

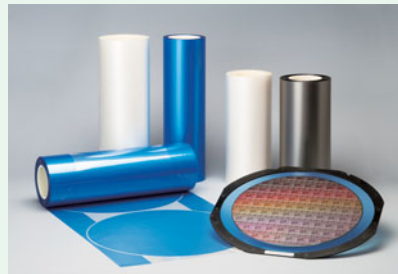


アドバンストマテリアルズ事業部門 (前期比)

売上高 **928億9**百万円 (9.2%増)

主要製品

- 半導体関連粘着テープ
- 半導体関連装置
- 積層セラミックコンデンサ関連テープ



オプティカル材事業部門 (前期比)

売上高 **79億16**百万円 (30.0%減)

主要製品

- 光学ディスプレイ関連粘着製品



事業部門別の売上高とセグメント営業利益の概況

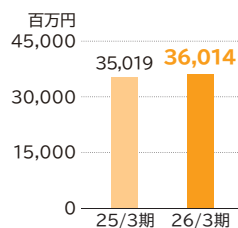
- アドバンストマテリアルズ事業部門は半導体関連装置が微減となりましたが、半導体関連粘着テープはAI関連の需要増加などにより好調に推移しました。積層セラミックコンデンサ関連テープはデータセンターやスマートフォン向けなどのハイエンド用の需要増加により、好調に推移しました。
- オプティカル材事業部門はOLEDディスプレイ用粘着テープが前期並みに推移したものの、韓国・台湾子会社の閉鎖影響もあり売上高は減少しました。
- セグメント営業利益は増産体制強化のために導入した新設備の減価償却費などの固定費は増加しましたが、半導体・電子部品関連製品の販売数量の増加により、前期に比べ増加しました。

洋紙・加工材関連 (前期比)

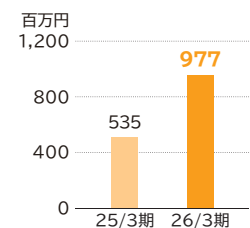
売上高 **360億14百万円** (2.8%増)

営業利益 **9億77百万円** (82.6%増)

売上高



営業利益



洋紙事業部門 (前期比)

売上高 **146億77百万円** (1.3%減)

主要製品

- カラー封筒用紙
- 色画用紙
- 特殊機能紙
- 高級印刷用紙
- 建材用紙



加工材事業部門 (前期比)

売上高 **213億36百万円** (5.9%増)

主要製品

- 粘着製品用剥離紙
- 光学関連製品用剥離フィルム
- 合成皮革用工程紙
- 炭素繊維複合材料用工程紙



事業部門別の売上高とセグメント営業利益の概況

- 洋紙事業部門は工業用特殊紙が堅調だったものの、主力のカラー封筒用紙や耐油耐水紙は需要減少により低調に推移しました。
- 加工材事業部門は合成皮革用工程紙が減少したものの、電子材料用を中心に剥離紙が堅調に推移したほか、光学関連製品用剥離フィルムや炭素繊維複合材料用工程紙の需要が回復しました。
- セグメント営業利益は原燃料価格や物流コストの上昇影響があったものの、洋紙事業で前期に実施した固定資産減損により営業損失が縮小したことに加え、加工材事業の増販効果もあり、前期に比べ増加しました。

※ セグメント別の営業利益はセグメント間取引消去前の数値に基づいています。

株式情報 (2026年3月31日現在)

株式の状況

発行可能株式総数	300,000,000株
発行済株式の総数 (ただし自己株式を除く)	65,481,432株
単元株式数	100株
株主数	8,143人



IRメール配信サービスのお知らせ

当社では新製品情報なども含め、株主・投資家の皆様へさまざまなニュースを幅広くお届けするため、IRメール配信サービスをご提供しています。配信をご希望の方は、当社IR情報サイトよりご登録をお願いいたします。



スマートフォンなどでこの二次元コードを読み取ると、登録ページへ簡単にアクセスできます。

www.lintec.co.jp/ir/ir_mail

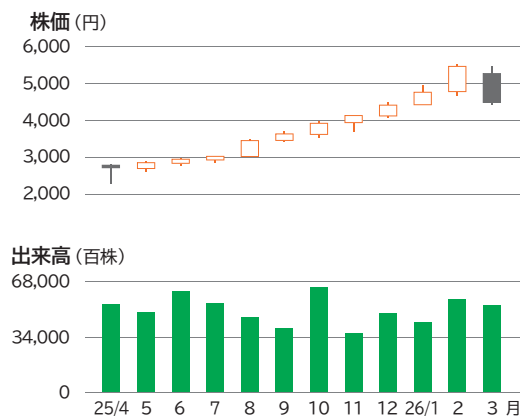
大株主の状況 (上位10位)

株主名	持株数(千株)	持株比率(%)
日本製紙株式会社	19,659	30.02
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	5,885	8.98
株式会社日本カस्टディ銀行(信託口)	3,788	5.78
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	1,701	2.59
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001	1,308	1.99
庄司 たみ江	1,226	1.87
リンテック従業員持株会	1,182	1.80
塩飽 恵以子	963	1.47
庄司 光江	797	1.21
明治安田生命保険相互会社	729	1.11

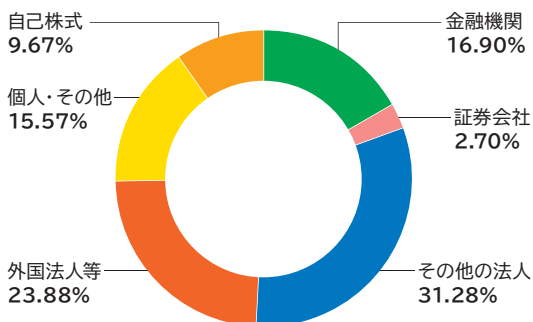
注1. 当社は自己株式7,007,308株を保有しておりますが、上記表からは除外しております。

注2. 持株比率の算定に当たっては、自己株式を控除して計算しております。

株価および出来高の推移 (2025年4月~2026年3月)



所有者別分布比率



株主メモ

定時株主総会	6月
配当基準日	期末：3月31日 中間：9月30日
株主名簿管理人および特別口座の口座管理機関	東京都千代田区丸の内1-4-5 三菱UFJ信託銀行株式会社
・郵便物送付先	〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
・フリーダイヤル	☎ 0120-232-711
・ホームページアドレス	www.tr.mufg.jp/daikou
住所変更、单元未済株式の買取・買増等のお申し出先について	株主様の口座のある証券会社にお申し出ください。なお、証券会社に口座がないため特別口座が開設されました株主様は、特別口座の口座管理機関である三菱UFJ信託銀行株式会社にお申し出ください。
未払配当金の支払いについて	株主名簿管理人である三菱UFJ信託銀行株式会社にお申し出ください。
株主総会資料の書面交付請求に関するご案内	株主総会資料の書面での交付を希望される場合は、株主様の口座のある証券会社または株主名簿管理人である三菱UFJ信託銀行株式会社にお申し出ください。
法定公告掲載ホームページアドレス	www.lintec.co.jp/ir/stock/koukoku.html



リンテック株式会社 *Linking your dreams*

● 本社 〒173-0001 東京都板橋区本町23-23
URL www.lintec.co.jp

発行 広報・IR室 2026年6月
TEL. (03) 5248-7741
FAX. (03) 5248-7754

社名の由来は、リンケージ(結合)とテクノロジー(技術)。ロゴマークは、地球を表す楕円にLINTEC・LINKAGE(結合)・LOYALTY(誠実)の三つの「L」で表現したウエーブ(波)を組み合わせてデザイン。世界を舞台に飛躍していこうという決意を込めています。



ユニバーサルデザイン(UD)の考えに基づいた見やすいデザインの文字を採用しています。